

公司代码：688783

公司简称：西安奕材

**西安奕斯伟材料科技股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

**ESWIN**

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

报告期内，公司实现产量 859.02 万片，较上年增长 33.55%，销量 807.37 万片，较上年同期增长 29.08%，实现营业收入 264,922.46 万元，较上年同期增长 24.88%，主要受新工厂产能爬坡导致转固折旧尚未被充分摊薄、持续高强度研发投入及市场增长传导的滞后性，综合导致公司尚未实现盈利，其中：报告期内，归属于母公司股东的净利润为-73,817.08 万元，与上年基本持平，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-80,933.75 万元，较上年亏损扩大 6.14%，截至报告期末，归属于母公司股东的未弥补亏损为 266,567.72 万元。

外部市场方面，根据 SEMI 最新发布的硅片行业年终分析报告，2025 年全球硅片出货面积同比增长 5.8%，销售额同比下降 1.2%。虽然数据中心与 AI 等领域投资维持高位，先进制程细分市场的需求旺盛，但下游需求向硅片环节传导存在一定滞后性；另一方面，汽车、工业及消费电子等传统应用仍处于库存调整阶段，整体供需关系尚未显著改善；加之国内硅片厂扩产产能集中释放，12 英寸硅片竞争加剧，产品价格阶段性承压。

内部经营方面，受到客户产能释放节奏、半导体硅片产品认证周期等因素影响，公司产品结构尚需进一步优化，报告期内公司正片（不含高端测试片）占主营业务收入比例约为 60%，正片占比尤其是应用于逻辑芯片的外延片产品占比尚需进一步提升。此外，公司上市募投项目即第二工厂总投资约 125 亿元，处于产能爬坡阶段，截至报告期末已具备 20 万片/月产能，较规划产能尚未完全释放，固定资产折旧等固定成本未能实现有效摊薄，规模效应暂未充分显现；加之公司为保障核心竞争力，报告期研发投入 28,515.26 万元，占营业收入比例 10.76%，持续维持较高强度的研发投入。多重因素共同导致报告期内公司业绩亏损。值得关注的是，公司报告期实现经营性现金流净流入 40,469.57 万元，持续保持现金流净流入，具备良好的可持续经营能力。

## 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-73,817.08万元，母公司净利润为-12,025.59万元。截至报告期末，母公司未分配利润为-61,618.55万元。

鉴于公司母公司报告期末未分配利润为负数，因此公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

由于母公司存在未弥补亏损，2025年度拟不进行利润分配。

## 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、 公司简介

#### 1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	西安奕材	688783	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨春雷	赵润欣
联系地址	陕西省西安市高新区西沣南路1888号	陕西省西安市高新区西沣南路1888号
电话	029-6827 8899（分机号：6927）	029-6827 8899（分机号：6927）
传真	029-6827 8899（分机号：6535）	029-6827 8899（分机号：6535）
电子信箱	ir@eswinsi.com	ir@eswinsi.com

## 2、 报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

硅片是芯片制造的“地基”，其性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力，根据 SEMI

统计，12英寸硅片贡献了2025年全球所有规格硅片出货面积78.8%，系最主流规格的硅片，尤其是AI时代需要更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互，而用于实现前述功能的市场最主流逻辑和存储芯片（一般90nm工艺制程以下）以及部分高端模拟和传感器芯片均采用12英寸晶圆制造工艺，12英寸晶圆产能是全球晶圆厂扩产的主流方向，未来12英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。公司专注于12英寸硅片的研发、制造和生产，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、AI等领域所需要的存储芯片、逻辑芯片、图像传感器、显示驱动芯片、电源管理芯片及IGBT、Power MOSFET等功率器件领域。从下游用途来看，可进一步分为用于芯片制造的正片、用于芯片制造设备调试和检测的测试片。其中，正片分为抛光片、外延片。公司当前主要布局用于存储芯片和逻辑芯片制造的抛光片和外延片，该等产品系市场主流，约占12英寸硅片市场75%份额，正在开拓布局细分市场领域。

## 1、抛光片

抛光片根据掺杂元素不同，可进一步分为P型轻掺抛光片、N型轻掺抛光片，其中：

(1) P型轻掺抛光片采用硼元素轻掺工艺，具有苛刻的晶体缺陷和纳米形貌等参数要求，主要应用于DRAM、NAND Flash等存储芯片的制造。公司系国内头部存储芯片厂商全球12英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商，同时持续向海外头部存储芯片厂商量产供应及新品导入。

(2) N型轻掺抛光片采用磷元素轻掺工艺，具备高电阻率、低氧含量、低缺陷密度的核心特性。作为功率IGBT器件的核心衬底材料，该产品可助力芯片实现高效能的电能转换与控制，广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、工业变频器等对功率密度和可靠性要求严苛的领域。公司持续优化晶体生长控制系统，成功开发出低氧含量、低晶体原生缺陷密度且电阻率范围可调的N型轻掺抛光片。公司第二工厂新增布局该细分领域，报告期内相关产品开发完成并通过下游客户验证。

## 2、外延片

外延片根据掺杂元素不同，可进一步分为P型轻掺外延片、P型重掺外延片、N型重掺外延片。其中：

(1) P型轻掺外延片是在P型轻掺抛光片基础上采用化学气相沉积技术生长一层外延层，主要应用于CPU\GPU\手机SOC\嵌入式MCU为代表的逻辑芯片制造，以及部分存储芯片、显示驱动芯片等，逻辑芯片对P型轻掺外延片的外延层形貌、平坦度以及外延层厚度和电阻率均匀性有着较高要求。公司系国内头部晶圆代工厂中国大陆12英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商，同时持续向海外头部晶圆代工厂量产供应及新品导入。

(2) P型重掺外延片是在P型重掺抛光片基础上生长一层外延层。其衬底的低电阻率等特性能够提升图像传感器芯片的光电转换效率与信号灵敏度，是图像传感器芯片的核心基底材料，公司针对体微缺陷(BMD)精准管控，开发重掺硼晶体生长工艺，实现BMD密度在一定区间范围可调，以满足图像传感器芯片对于BMD吸杂的高要求。同时，公司持续加强各工艺段污染管控技术，降低硅片表面金属、层金属和体金属水平。公司相关产品最高已在40nm背照式CIS产品量产应用。

(3) N型重掺外延片是在高掺杂浓度的N型重掺抛光片所需工序基础上生长外延层，具有低导通电阻和高外延晶体质量的双重优势。该产品主要应用于制造Power MOSFET功率芯片。Power MOSFET功率器件对电阻率和电阻率均匀性要求极高，公司开发了重掺红磷晶体生长控制系统，成功拉制出重掺红磷的N++晶体，实现产品超低电阻率可控。公司第二工厂新增布局该细分领域，报告期内相关产品已开发完成，正在推进客户送样工作。

## 3、测试片

测试片用于晶圆厂对产线设备、工艺环境的调试、检测和验证，不直接用于晶圆制造。由于应用要求不同，测试片具有不同的等级，不同等级测试片之间产品技术参数和单价有明显差别，部分测试片的品质要求和价格与抛光片相近，甚至更高。

## 2.2 主要经营模式

### 1、盈利模式

公司专注于12英寸硅片的研发、制造和销售业务，系国内唯一专注于该领域的厂商，通过向下游芯片制造商提供12英寸硅片实现收入、取得利润。一方面，公司凭借国内领先的市场地位及技术水平，不断优化产品结构，提高收入水平；另一方面，公司建立智能化生产体系，具备较高的系统化成本管控能力，不断提升精益化管理水平，持续提升盈利能力。

### 2、研发模式

公司高度重视自主研发及知识产权保护，建立了“量产一代、储备一代、研发一代”研发体系，汇聚“产学研”多方力量，担当地方产业链“链主”责任，联合产业链上下游企业共同攻关，协同创新。

公司作为研发技术中心，负责前瞻性技术研究，若研发项目需依托产线开展试验、验证、量产等相关工作时，则以公司为主体，各工厂协同配合，共同推进联合研发。其次，公司将研发活动分为技术研发、产品研发、工艺研发三大类：

(1) 技术研发：公司基于现有能力，针对新技术的创新性研发活动，包括但不限于针对新技术自主设计设备核心部件、新工艺的前瞻性设计、模拟及测试开发等，取得的研发成果一般为新工艺技术、先进的量测技术或创新性成果专利；

(2) 产品研发：根据行业规格现状或公司发展计划将新技术应用于产品之上，以满足下游客户技术迭代和应用需求，取得的研发成果一般为导入量产的新产品；

(3) 工艺研发：针对已有的工艺流程、工艺方法和材料耗用及配比等方面进行优化调整及设备智能化改造开发，包含原材料、耗材和设备的国产化导入研发项目，取得的研发成果一般为工艺方案文档等；

此外，公司在现有研发体系基础上，不断推进研发体系数字化、标准化，逐步形成多个标准化研发平台，提升资源复用能力及研发效率。

### 3、采购模式

首先，公司为供应链企划和管理中心，做出采购决策；各工厂为具体采购主体，根据公司采购决策情况与供应商签订采购合同。

其次，公司制定了严格的合格供应商准入制度和供应商管理制度，综合评估产品质量、经营规模、供应能力等因素，参考全球硅片行业头部企业和自身实际情况，将优质供应商纳入合格供应商名录，并对合格供应商实施筛选、调查、分级管理及评价。同时考虑供应商多元化和采购成本优化，公司积极培育12英寸硅片所需原材料、耗材及设备等国产供应商，是陕西省工业和信息化厅确定的“第一批陕西省重点产业链‘链主’企业”。

第三，公司通过询价、比价、议价、招投标方式确定供应商。对于主要原材料，公司采用“以销定产，以产定采，适量备货”的采购模式，一般根据未来一年经营规划制定年度采购方案，根

据具体的生产计划、研发计划和安全库存制定采购计划并向供应商下达采购订单。为确保物资供应的稳定性和品质，公司建立了多元化的供应商体系，主要物资合格供应商数量不少于两家，并与合格供应商签订框架协议。对于主要设备采购，公司根据产能建设计划制定设备采购计划，通过招投标、询价、比价方式进行采购。

#### 4、生产模式

首先，公司以各工厂为生产主体，产品完成生产后，均销售至公司，最终由公司统一外售。

其次，公司主要采用“以销定产”的模式，配套建立科学的产销协同机制。首席营销官组织与主要客户一般于年末提前沟通下一年度的采购需求，对生产进行预计和规划；首席营销官组织根据客户具体采购意向和采购订单提出具体生产需求，并制定销售计划；首席制造官组织结合销售计划、材料库存信息制定生产计划。生产完成后，由首席品质官组织对产品质量进行检验后完成入库。鉴于客户及产品认证数量不断增长，考虑客户采购需求以及生产周期等诸多因素，公司会根据市场和客户具体情况提前备货生产，保障供应链响应效率。

第三，公司首席制造官组织下设智造技术中心推进智能化工厂建设，旨在实现产品个性化、设计协同化、供应敏捷化、制造柔性化、服务主动化、决策智能化。在生产过程中，公司利用自动派送系统（RTD）实现对硅片位置的准确定位、智能化分析，从而达到高效的生产运营管理；利用 AMHS 系统对天车（OHT）与移动机器人的管理调派实现硅片在设备及库房间的自动转运，是目前国内自动化程度最高的硅片工厂之一。同时，公司以 ERP 系统为企业运营管理的核心系统，综合运用负责产品研发和管理的 PLM 系统、负责生产制造的 MES 系统、负责成品入库及交付管理的 FGMS 系统、负责设备自动化程序的 EAP 系统等，实现企业运营的高效决策和执行。

此外，公司积极学习、应用 AI 技术，组建 AI 智造创新中心，探索将机器学习和大语言模型引入生产制造和运营管理的各个环节，通过建立硅片加工工序纳米形貌预测模型、12 英寸专利智能检索系统，持续提升生产智能化水平。未来，公司还将在智能排产、生产异常追溯、开发设计等环节引入 AI 技术，助力公司生产运营效率、品质管控能力、研发能力的提升。

#### 5、销售模式

首先，公司为对外销售合同签订主体和回款主体。

其次，根据行业惯例，晶圆厂在引入新供应商时，会在审查通过供应商的技术实力、品控体系和产能规模等条件后，要求供应商先行提供测试片进行认证，认证周期正常为 3-6 个月；认证通过后，可以进行测试片量产供货。测试片量产供货后，根据晶圆厂内部评估，可进一步开展正片验证，验证周期正常为 9-12 个月；验证通过后，方可实现正片量产供货，后续晶圆厂根据对供应商定期评价增减其供货比例。整体来看，新进入者仅考虑测试片送样到正片量产至少需要 1-2 年周期，由于认证周期较长并且认证成本较高，一旦认证通过，晶圆厂商通常不会轻易更换供应商。

第三，公司对外销售主要采用直销模式，少量客户由于贸易政策限制等因素采取代理商销售模式，报告期内代理商销售模式收入不超过 5%。

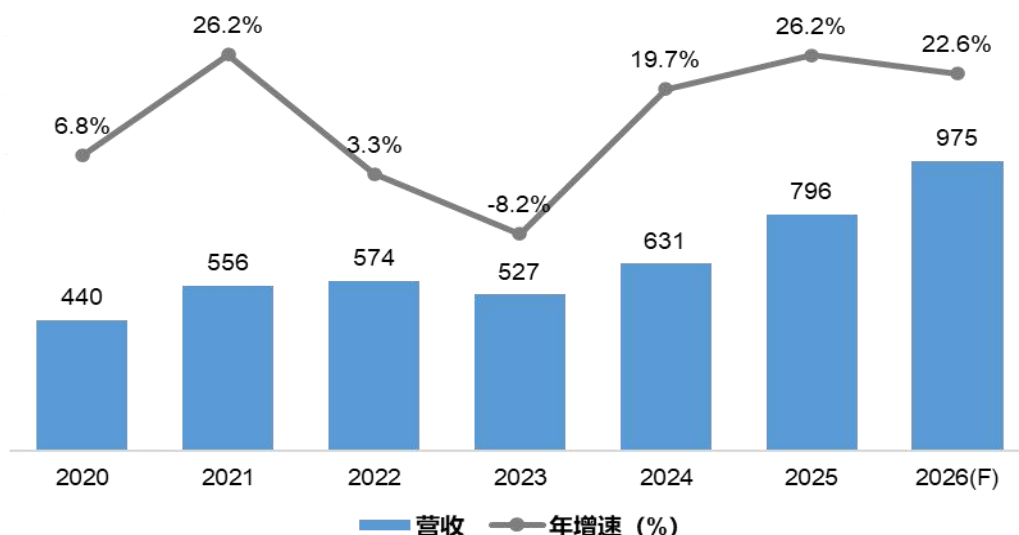
### 2.3 所处行业情况

#### (1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 行业的发展阶段

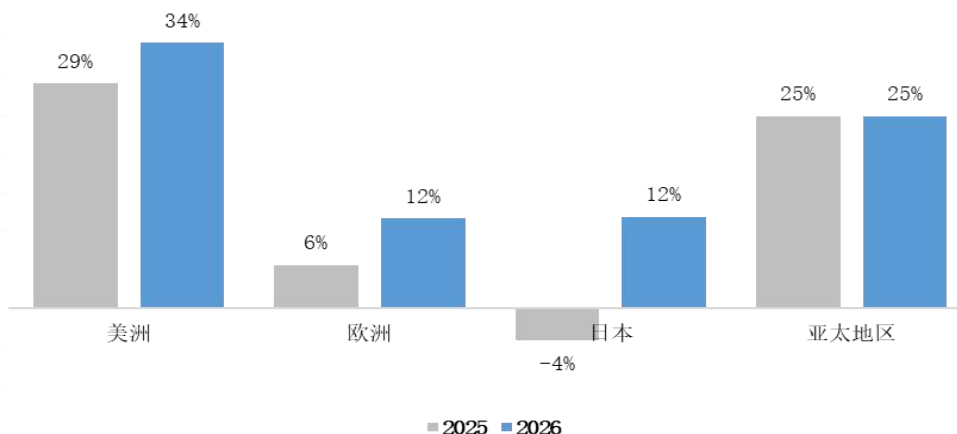
长期来看，半导体行业兼具周期波动与持续成长的双重属性。2022-2024年，全球半导体行业经历周期性调整，市场景气度承压。2025年全球半导体行业迎来结构性复苏，AI、数据中心等应用对算力及存储领域需求的增长成为驱动行业增长的核心引擎，传统应用需求逐步复苏，库存持续调整，行业整体处于筑底调整与动能积蓄阶段。据WSTS预测，2025年全球半导体市场规模将达到7,956亿美元，同比增幅扩大至26.2%。2026年全球半导体市场规模将逼近万亿美元，分区域来看，欧洲和日本表现温和，增速维持在个位数，美洲和亚太地区仍是贡献最强的地区，预计将增长25%至30%。

图 1. 全球半导体市场营收预测（单位：十亿美元）



数据来源：WSTS

图 2. 全球半导体市场各区域营收增速预测



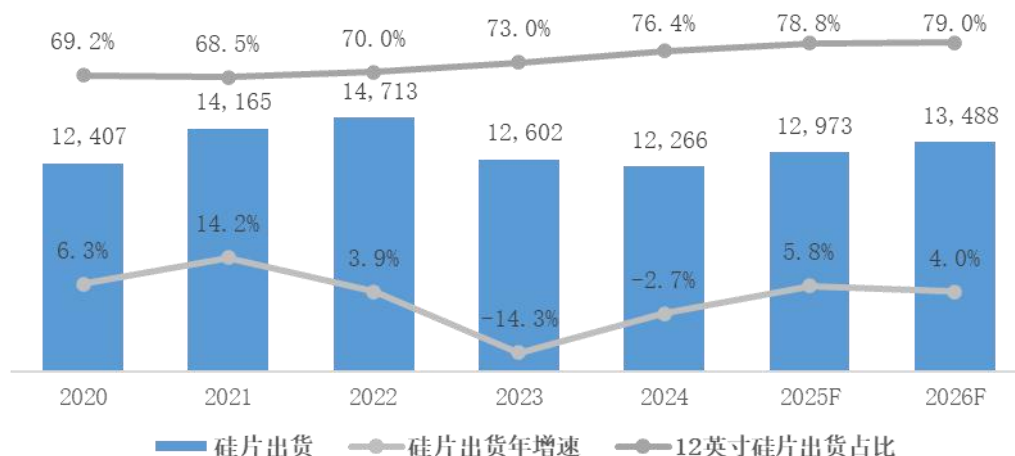
数据来源：WSTS

在全球市场呈现结构性复苏与区域分化的背景下，作为全球最大的半导体消费市场和重要的增长极，中国集成电路产业发展强劲，展现出良好的韧性。国家统计局数据显示，2025年，中国集成电路产量为4,843亿块，同比增长10.9%。

硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。受益于数据中心、AI对先进制程逻辑芯片、存储芯片相关需求的强劲推动，以及传统应用领域需求的复

苏，12 英寸硅片市场进入上升周期。据 SEMI 预测，2025 年全球硅片出货面积预计将增长 5.8%，达到 12,973 百万平方英寸，2026 年将继续保持增长趋势，出货面积预计将达到 13,488 百万平方英寸，同比增长 4.0%。12 英寸硅片为当前市场主流规格。据 SEMI 预测，2025 年其占全球硅片出货面积的比重约为 78.8%，未来 12 英寸硅片占比将进一步提升。

图 3. 全球硅片市场出货面积预测（单位：百万平方英寸）



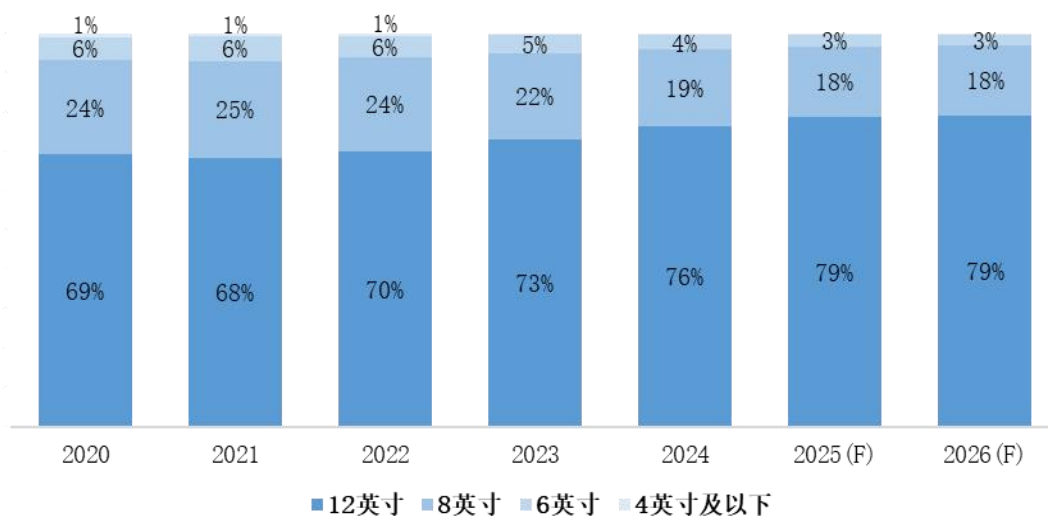
数据来源：SEMI

## (2) 行业的基本特点

从行业周期看，硅片行业与全球半导体市场波动同频，短期虽有起伏，但长期趋势向好。当前行业呈现出先进制程与成熟制程需求显著分化的特征。一方面，数据中心与 AI 等领域投资维持高位，带动先进制程细分市场的需求旺盛，成为市场增长的核心动力，同时推动全产业链在高端领域加大投资、调整布局；另一方面，汽车、工业及消费电子等传统应用库存持续调整。需求的结构分化推动产业链布局加速调整，以匹配市场增长。半导体硅片需求进一步扩大。在 AI 与多元终端应用的驱动下，2025 年晶圆厂持续扩产，带动硅片行业进入上升周期。据 SEMI 预测，2026 年全球 12 英寸晶圆厂量产数量预计达 215 座，其中中国大陆将达到 70 座。全球芯片厂持续扩产，将持续推升 12 英寸硅片需求。据 SEMI 预测，2025 年全球硅片出货面积将同比增长 5.8% 至 12,973 百万平方英寸，并预计在 2026 年达到约 13,488 百万平方英寸。

12 英寸硅片系硅片市场主流，据 SEMI 预测，12 英寸硅片约贡献了 2025 年全球所有规格硅片出货面积的 78.8%。2025 年全球 12 英寸硅片出货面积预计达到约 10,117 百万平方英寸，同比增长 8.8%。2026 年出货面积将进一步攀升至约 10,649 百万平方英寸，同比增长 5.3%，增速显著高于行业平均水平，市场份额将进一步提升至接近 80%。

图 4. 12 英寸硅片出货面积占比



数据来源：SEMI

### (3) 主要技术门槛

半导体硅片是芯片制造的核心基础材料，广泛应用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造。该行业进入壁垒高，具有技术密集、资本密集、研发周期长、客户认证严苛等显著特征。半导体技术向先进制程持续演进，对硅片材料的单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出更严苛要求。作为市场主流的 12 英寸硅片，技术发展聚焦于缺陷控制、表面平坦度及局部平整度等关键指标，以满足先进存储芯片及高端逻辑芯片的制造需求。这些关键技术的突破与稳定量产能力，是决定产品性能与良率的核心，也构成了行业内企业最主要的竞争壁垒。

公司已掌握多项关键技术，涵盖无缺陷晶体生长技术、翘曲和弯曲控制技术、硅片表面平坦度控制技术、表面污染控制技术以及外延设备基座、反应腔室改善设计等核心技术，实现 12 英寸硅片全工艺环节覆盖，技术处于国内行业前列，全球竞争力持续增强。

### (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

全球 12 英寸硅片市场呈现“海外主导、国内追赶”的竞争格局，行业具有技术密集、资本密集、研发与认证周期长等特点，长期由日本信越化学、SUMCO 及中国台湾环球晶圆等国际企业主导。在政策引导与产业支持下，国内企业正加快技术突破与产能建设，市场份额逐步提升，国产替代持续深入。

作为国内 12 英寸硅片头部企业，公司坚持“以客户为中心、以技术为基石、以品质为生命、以成果为导向、以奋斗者为本、以自省促卓越”的核心价值观，秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的愿景。目前，公司系国内头部存储芯片厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商、国内头部晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。公司在立足国内市场的同时，持续服务全球客户，报告期内持续向台积电、美光科技、铠侠、格罗方德、力积电、联华电子、华邦、南亚科等稳定批量供货并不断进行新产品验证，首次实现三星电子、东芝少批量测试片供货，正在推动其正片认证工作。整体上，全球前五大厂商仍是海外主流客户的主要供应商，国内供应商占比仍有较大提升空间，提升海外客户供应份额将持续作为公司后续市场开拓的重点工作。展望未来，公司将持续提升产品技术、产品质量与客户服务水平，进一步提升市场竞争力，特别是快速提升海外市场供应量，扩大全球市场份额。

**(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势****(1) 新技术：发展路径趋于多元，推动硅片价值提升**

行业技术正沿着“延续摩尔”和“超越摩尔”两个方向并行发展，拓宽了硅片的市场空间与价值。“延续摩尔”指芯片制程继续微缩至 2nm 及更先进节点，这对硅片的平整度和缺陷等参数控制提出了更加苛刻的要求，驱动制造技术不断突破极限。“超越摩尔”则指通过集成射频、功率等特色功能来提升芯片性能，这催生了多元化特色硅片产品的快速增长。

**(2) 新产业：AI 等新兴产业有望创造新的增长点**

以 AI 为代表的新兴产业，为硅片行业带来新机遇。AI 服务器算力需求激增，叠加高带宽内存（HBM）等关键存储技术的快速迭代，有望创造硅片行业新的增长点。

**(3) 新业态与新模式：产业链协同深化，响应速度成为关键**

为适应技术快速迭代和市场多样化需求，产业内的协作模式与运营方式正在发生深刻变化。下游晶圆厂与硅片供应商的合作关系日益紧密，从传统的买卖关系转向“共同开发、联合认证”的深度绑定模式；并积极将服务向前延伸，配合客户协同开发，以技术服务和快速响应来构建新的竞争优势。

**3、公司主要会计数据和财务指标****3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,069,812.89	1,742,196.67	18.80	1,549,762.42
归属于上市公司 股东的净资产	1,241,705.57	851,481.36	45.83	922,405.46
营业收入	264,922.46	212,145.26	24.88	147,376.14
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	263,607.46	211,087.28	24.88	146,031.45
利润总额	-73,816.97	-73,764.25	不适用	-68,191.43
归属于上市公司 股东的净利润	-73,817.08	-73,764.25	不适用	-57,797
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-80,933.75	-76,255.09	不适用	-69,233.88
经营活动产生的 现金流量净额	40,469.57	81,547.82	-50.37	31,990.45
加权平均净资产 收益率(%)	-8.24	-8.32	增加0.08个百分 点	-6.02
基本每股收益(元)	-0.21	-0.21	不适用	-0.17

/ 股)				
稀释每股收益(元 / 股)	-0.21	-0.21	不适用	-0.17
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.76	12.20	减少1.44个百分点	11.63

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	65,415.46	64,828.73	63,026.80	71,651.47
归属于上市公司股东的净利润	-14,483.77	-19,541.68	-21,756.66	-18,034.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,536.37	-20,004.68	-22,239.57	-24,153.13
经营活动产生的现金流量净额	16,851.38	20,704.40	7,453.65	-4,539.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4、 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	53,718					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,939					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/					
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数	质押、标记或 冻结情况	股东 性质

				量	股份 状态	数量	
北京奕斯伟科技集团有限公司		445,627,284	11.04	445,627,284	无		境内 非国 有法 人
北京奕行私募基金管理有限公司—宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)		349,913,933	8.67	349,913,933	无		其他
西安高新技术产业风险投资有限责任公司—陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)		317,256,738	7.86	317,256,738	无		其他
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司		262,435,103	6.50	262,435,103	无		国 有 法人
宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)		140,934,731	3.49	140,934,731	无		其他
中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)		122,468,977	3.03	122,468,977	无		其他
嘉兴隼望股权投资合伙企业(有限合伙)		116,637,978	2.89	116,637,978	无		其他
重庆渝富资本私募基金管理有限公司—重庆渝富芯材私募股权投资基金合		113,725,245	2.82	113,725,245	无		其他

合伙企业（有限合伙）							
中信证券投资有限公司	11,600,928	88,474,921	2.19	88,474,921	无		境内非国有法人
中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司—扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业（有限合伙）		87,477,445	2.17	87,477,445	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>(1) 奕斯伟集团直接持有公司 11.04%的股份，为公司第一大股东。奕斯伟集团为宁波奕芯股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人，北京奕行为宁波奕芯股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和基金管理人，奕斯伟集团可全权代表宁波奕芯股权投资合伙企业（有限合伙）行使对发行人的股东权利，奕斯伟集团和宁波奕芯股权投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系；</p> <p>(2) 奕斯伟集团 21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业（有限合伙）和宁波庄宣投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为宁波宣岳股权投资有限公司；</p> <p>(3) 奕斯伟集团 21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业（有限合伙）、宁波奕芯股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴隼望的唯一有限合伙人，宁波庄宣投资合伙企业（有限合伙）的主要有限合伙人城市更新股权投资（青岛即墨）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人均为中国人寿保险股份有限公司；</p> <p>(4) 中信证券投资有限公司为中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例约 0.67%的有限合伙人。</p> <p>除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			/				

#### 存托凭证持有人情况

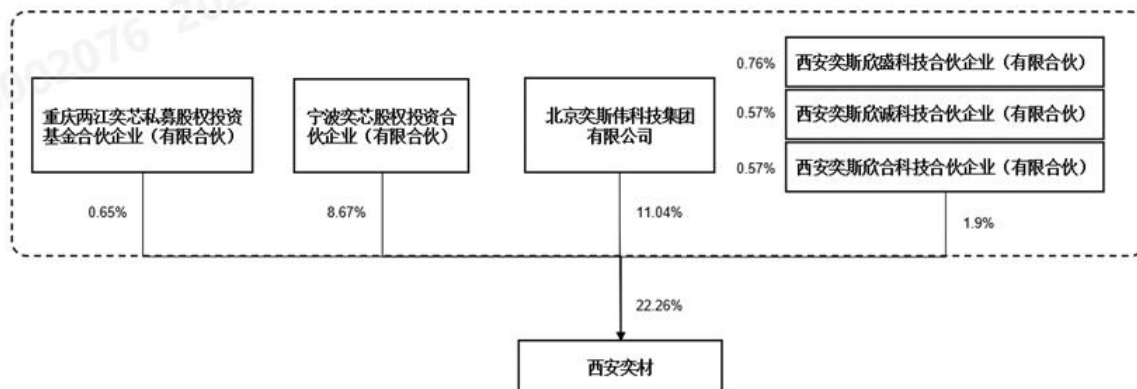
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

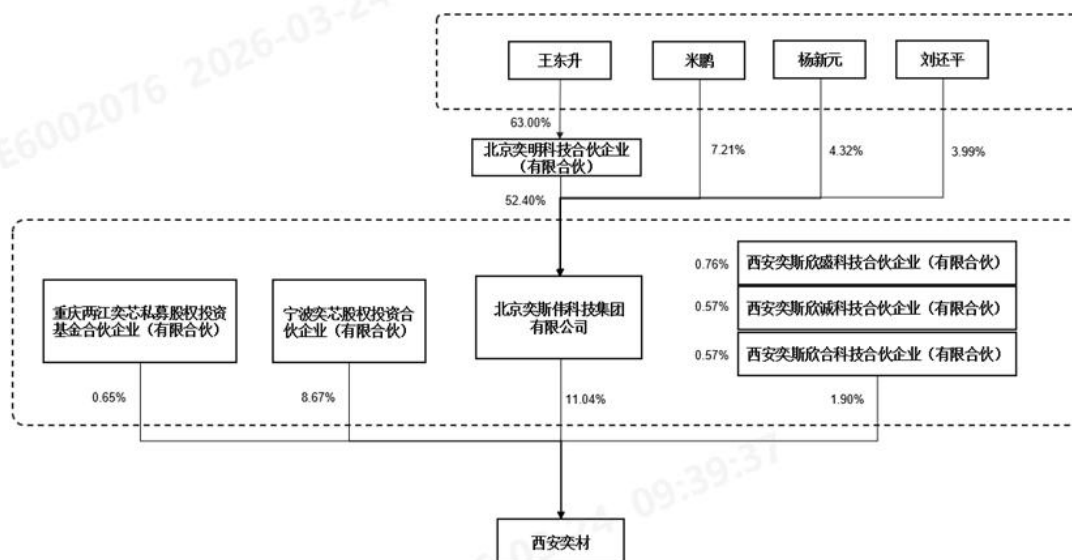
√适用 □不适用



注：奕斯伟集团及其一致行动人奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣合、宁波奕芯和重庆奕芯直接控制公司 22.26%的股份

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：王东升、米鹏、杨新元和刘还平为公司实际控制人，四人直接和间接控制公司控股股东奕斯伟集团合计 67.92%的股权

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5、公司债券情况

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用